



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στο πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος «ΡΑΝΤΑΡ MIS 5032784 Τ1ΕΔΚ-00329» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια οργάνου χάραξης ψηφίδων ημιαγωγικών διατάξεων, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

### ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### **Σύστημα χάραξης ημιαγωγικών υποστρωμάτων / Semiconductor substrate scribing system**

- Απαιτείται ακριβής χάραξη και κοπή ημιαγωγικών υποστρωμάτων με οπίσθια χάραξη ευθυγραμμισμένη ως προς την τοπογραφία της εμπρόσθιας επιφάνειας του υποστρώματος
- Η χάραξη δεν πρέπει να επηρεάζει / καταστρέφει την εμπρόσθια επιφάνεια του υποστρώματος
- Ακρίβεια χάραξης μικρότερη ή ίση με  $\pm 200 \mu\text{m}$
- Απαιτείται προσαρμοστικότητα για διάφορα μεγέθη και σχήματα υποστρωμάτων
- Απαιτείται ικανότητα χάραξης κρυσταλλικών και άμορφων υποστρωμάτων για μετέπειτα κοπή
- Μήκος χάραξης τουλάχιστον 100 mm
- Ικανότητα αντικατάστασης διαμαντιού χάραξης, όπου να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης ύψους και γωνίας χάραξης
- Σύστημα ολοκληρωμένου μετρητικού μήκους για ακριβή και επαναλήψιμη ευθυγράμμιση και διαστασιολόγηση
- Demand for accurate cleaving through frontside targets with a scribe made on the backside of the substrate
- Scribe must not damage the frontside of the sample
- Accuracy of scribe  $\pm 200 \mu\text{m}$
- Required flexibility with respect to sample size and shape
- Required capability of scribing bonded crystalline and amorphous wafers and chips for subsequent cleaving
- Scribing length at least 100 mm
- Prealigned diamond scribe in user replaceable cartridge; height and angle adjustable
- Integrated ruler embedded in platform for precise and repeatable sample alignment and sizing

#### **Σετ 2 ταναλιών τελικής κοπής / Set of 2 pliers for the final cleaving**

- Τανάλιες κοπής για καθαρή και ασφαλή κοπή ολόκληρου υποστρώματος πλήρης διαμέτρου
- Ικανότητα κοπής κρυσταλλικών, γυάλινων και κεραμικών υποστρωμάτων
- Cleaving Pliers that enable clean and safe whole wafer cleaving.
- Cleaving capability for crystalline, glass and ceramic substrates

Προϋπολογισμός δαπάνης 4.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 30/3/2019

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, ο χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

**Πληροφορίες:**

A. Σταυρινίδης

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.)

N. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

τηλ.: +30 2810394143

Φαξ: +30-2810-394106

e-mail: [astav@physics.uoc.gr](mailto:astav@physics.uoc.gr)

Ηράκλειο 20/3/2019

Για το ΙΗΔΛ – ΙΤΕ

Ο Διευθυντής

Σπύρος Αναστασιάδης